

2-1-1-2 AWF 合せズレ／AWF 対位的偏移／Phototool misalignment

【特徴】P S R パターンが同一方向に回路導体に被っている状態のズレ

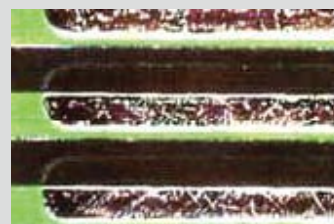
【特徴】PSR 图形爬上同一方向线路的偏移。

【Characteristics】Photo solder resist pattern is shifted in the same direction and covers conductors that must be uncovered.

【原因・判断ポイント・発生工程】P S R パターン用 A W F の合わせ技能が未熟な為に出来たもの（P S R パターン露光焼付～現像）

【原因、判断要点、发生工序】因为 PSR 图形的 AWF 对位技能生疏所引起的（SR 图形曝光～显影）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The misalignment is a work of an unskilled technician of using a phototool for photo solder resist patterning (Photo solder resist imaging - development)



【コメント】
顕微鏡倍率×10

【注釋】
显微镜倍率×10

【Comments】
Magnification: ×10



【コメント】
顕微鏡倍率×12.5

【注釋】
显微镜倍率×12.5

【Comments】
Magnification: ×12.5

2-1-1-3 カバーレイ貼りズレ／覆盖膜的压合偏移／Inaccurate coverlay placement

【特徴】カバーレイが所定の位置からずれている状態の欠陥

【特徴】覆盖膜偏离规定位置的偏移。

【Characteristics】Coverlay is displaced from the right position.

【原因・判断ポイント・発生工程】カバーレイ貼り付け作業ミス、または仮貼り後のマテハン中にずれて出来たもの（カバーレイ仮貼り工程、本貼りプレス前マテハン工程）

【原因、判断要点、发生工序】覆盖膜压合作业错误，或者临时固定后在搬运中移位而引起的（覆盖膜压合工序、临时固定后的搬运工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Coverlay is attached to a wrong position by mistake or displaced during material handling after it is temporarily applied. (Coverlay temporary application or during material handling before final cure)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×

【注釋】
FPC
显微镜倍率×

【Comments】
FPC
Magnification: ×